

半导体行业专用压力表 GW28

概述

该产品可测量高纯度的半导体气体，可用于存在腐蚀性的空气等恶劣的场合，由于制作时充分考虑到该产品的气密性和清洁度，因此非常适合应用于半导体生产线和测量高纯净流体。

特征

- 外型小巧，直径只有28mm，便于集成化安装。
- 接气部为隔膜，和传统的C型波登管不同，这种构造便于用户清洁及充气包装。

※请将压力的范围置于满刻度的30%~65%之间，这时压力表的测量最准确。也请确定压力表接液部的材质是否适合被测流体。



规格

测量介质:

气体或液体

形状:

面板安装  D型(中心底座轴向)

表盘尺寸:

φ28

连接口径:

1/4VCR (M)、1/4VCR (F)、1/4UJR (F)

接液部材质:

隔膜·底座 EP级: SUS316L
BA级: SUS316L
外壳 SUS304原色
内部机芯 SUS制

焊接方式:

氩弧焊接

压力范围:

-0.1~0.2MPa
-0.1~0.4MPa
-0.1~1MPa

最大耐压:

压力范围的1倍

使用温度范围:

-5~40°C

精度:

±3%F.S.

气密性 (He真空法):

$1.01 \times 10^{-9} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ 以下

清洁度:

EP级: 直径0.2 μm以上的微粒少于10个
BA级: 等级 (ANSI B40、1M-1979)

构造



